

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2025-045

杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放是否符合公司规定：是
- 募集资金使用是否符合承诺进度：不适用

一、募集资金基本情况

(一) 2023 年向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。

2. 募集资金使用计划及调整

(1) 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局 2204-330114-89-02-524827

SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局 2207-350205-06-02-858369
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备 〔2210-510121-04-01-381195〕 FGQB-0490 号
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	
合 计	1,005,000.00	650,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司士兰集昕公司、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称厦门明镓公司）、汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、成都士兰公司进行增资。

（2）募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合 计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

3. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	491,306.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	274,515.56
	利息收入净额	B2	2,382.92
本期发生额	项目投入	C1	11,691.94
	利息收入净额	C2	163.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	286,207.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,546.91
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金		E	99,915.10
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	107,730.42
实际结余募集资金		G	107,730.42

二、募集资金管理情况

（一）2023年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2023年12月11日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月3日，公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月19日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	19033101040036623	924,964,776.82	募集资金专户

厦门明镓公司	国家开发银行厦门市分行	35200109000000000059	15.58	募集资金专户
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	51100100000000000625	152,339,367.26	募集资金专户
合 计			1,077,304,159.66	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2023 年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(2) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2024 年 2 月 1 日第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,885.82 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 150.97 万元。

(3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用 100,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 2 月 7 日将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 100,000 万元全部提前归还至募集资金专项账户。

根据公司 2025 年 2 月 14 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 100,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用 99,915.10 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

(4) 节余募集资金使用情况

募集资金投资项目“SiC 功率器件生产线建设项目”已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，公司已于 2025 年 6 月 30 日将该项目予以结项，并拟将项目结余募集资金 15.58 元转入一般账户用于永久补充流动资金。公司已于 2025 年 7 月将该项目结余募集资金 15.58 元转出至一般账户，并将该募集资金专项账户销户。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2023 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日

附件 1

2023 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				491,306.11		本年度投入募集资金总额					11,691.94	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					286,207.50	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	否	300,000.00	160,000.00	未作分期承诺			-160,000.00		2026 年 12 月	2025 年上半年, 该项目实现销售收入 7,907.34 万元, 实现销售毛利 2,926.86 万元, 实现利润总额 2,716.42 万元	不适用	否
SiC 功率器件生产线建设项目	否	75,000.00	75,000.00	未作分期承诺	287.08	75,090.34	90.34	100.12	2025 年 6 月	2025 年上半年, 该项目实现销售收入 9,455.02 万元, 实现销售毛利 -4,264.16 万元, 实现利润总额 -9,527.61 万元	否（注）	否

汽车半导体封装项目(一期)	否	110,000.00	110,000.00	未作分期承诺	11,404.86	64,811.05	-45,188.95	58.92	2026年12月	2025年上半年,该项目实现销售收入37,379.17万元,实现销售毛利-1,706.87万元,实现利润总额-7,692.95万元	不适用	否
补充流动资金	否	165,000.00	146,306.11	未作分期承诺		146,306.11		100.00	不适用			
合 计	—	650,000.00	491,306.11	—	11,691.94	286,207.50	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					根据公司于2024年11月25日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,“年产36万片12英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目(一期)”是公司完善高端功率半导体领域的重要战略布局,项目建设整体规模较大、资金需求较高。在项目实施过程中,受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM企业各环节产线配套建设情况等因素的影响,公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境,募投项目的实施进度、实际建设情况、项目建设周期以及公司业务发展需求(包括应对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整)等因素,同时为更好控制投资风险,基于审慎性原则,将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(一)1(2)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告三(一)1(3)之说明							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本专项报告三(一)1(4)之说明							
募集资金其他使用情况					无							

注:为适应当前 SiC 市场变化较快的形势,厦门明镓公司增加了对“SiC 功率器件生产线建设项目”的投入,在年产 14.4 万片生产能力不变的基础上,实现产品结构升级。